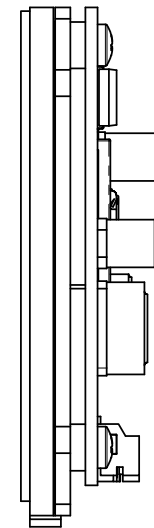


Rev. Reason
訂正理由

- (1) 筐体設計を行う場合は端子部分を除きFPCケーブルを金属などの導体に接触しない様に設計を行って下さい。
導体に接触している場合、FPCケーブルの絶縁層が破壊されショートする可能性があります。
- (2) 本製品のタッチパネルは封止型のためタッチパネル表面が膨らんでいます。
- (3) タッチパネルは封止型のためタッチパネルの上層電極のフィルムが温湿度変化により伸縮します。
フィルムにストレスが加わらないように筐体設計を行って下さい。
以下2点に関しては必ず注意して筐体設計を行って下さい。
 - ・ 緩衝材を使用する場合は必ず筐体側に緩衝材を固定して下さい。
タッチパネル側に固定はしないでください。
 - ・ 筐体とタッチパネル操作エリアは一定間隔(0.2mm~0.3mm)を設けて設計して下さい。
- (4) 液晶の詳細に関しては液晶詳細図「D15620-X005」を参照して下さい。

Technical drawing of a 2-layer PCB assembly. The drawing shows a side view of the assembly with various components and dimensions. The dimensions are:

- Overall height: 20 ± 1
- Top layer thickness: 4.55 ± 0.5

The components shown include:

- 2 (板金) - 2 (Sheet Metal)

Total	
-------	--

配布先